

公司代码：688256

公司简称：寒武纪

中科寒武纪科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案拟定如下：

（1）向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至董事会决议日，公司总股本421,685,170股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份36,600股后，实际可参与利润分配的股数为421,648,570股，以此计算合计拟派发现金红利632,472,855.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.71%。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,061,625.99元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计652,534,480.99元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.69%。

（2）向全体股东每10股转增4.9股。截至董事会决议，公司总股本421,685,170股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份36,600股后，实际可参与公积金转增股本的股数为421,648,570股，本次转股后，公司的总股本为628,292,969股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	寒武纪	688256	无

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶湔尹	童剑锋
联系地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层
电话	010-83030796-8025	010-83030796-8025
传真	010-83030796-8024	010-83030796-8024
电子信箱	ir@cambricon.com	ir@cambricon.com

2、 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，让机器更好地理解和服务人类。公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。目前，公司的主要产品线包括云端产品线、边缘产品线、IP 授权及软件。

1、 云端产品线

云端产品线目前包括云端智能芯片及板卡、智能整机。其中，云端智能芯片及板卡是云服务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件，其主要作用是云计算和数据中心场景下的人工智能应用程序提供高计算密度、高能效的硬件计算资源，支撑该类场景下复杂度和数据吞吐量高速增长的人工智能处理任务。

公司的智能整机是由公司自研云端智能芯片及板卡提供核心计算能力的服务器整机产品。公司的智能整机产品与智能计算集群系统业务的区别在于智能整机主要提供计算集群中的单体服务器，而不提供全集群搭建服务，主要面向有一定技术基础的商业客户群体。

2、边缘产品线

边缘计算是近年来兴起的一种新型计算范式，在终端和云端之间的设备上配备适度的计算能力，一方面可有效弥补终端设备计算能力不足的劣势，另一方面可缓解云计算场景下数据隐私、带宽与延时等潜在问题。边缘计算范式和人工智能技术的结合将推动智能制造、智能零售、智能教育、智能家居、智能电网等众多领域的高速发展。

3、IP 授权及软件

该产品线包括 IP 授权和基础系统软件平台。IP 授权是将公司研发的智能处理器 IP 等知识产权授权给客户在其产品中使用。基础系统软件平台是公司云边端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件(包含软件开发工具链等)，打破了不同场景之间的软件开发壁垒，兼具灵活性和可扩展性的优势，无须繁琐的移植即可让同一人工智能应用程序便捷高效地运行在公司云边端系列化芯片与处理器产品之上。

4、智能计算集群系统业务

公司智能计算集群系统业务是将公司自研的智能计算板卡或智能整机产品与合作伙伴提供的服务器设备、网络设备与存储设备结合，并配备公司的集群管理软件组成的数据中心集群。智能计算集群主要聚焦人工智能技术在数据中心的应用，为人工智能应用部署技术能力相对较弱的客户提供软硬件整体解决方案，以科学地配置和管理集群的软硬件、提升运行效率。

2.2 主要经营模式

从产业模式来看，集成电路企业主要包括 IDM(垂直整合制造)、Fabless(无晶圆厂)、Foundry(代工厂)以及 OSAT(封装测试企业)，集成电路设计行业运营模式主要为其中的 IDM 模式和 Fabless 模式。

公司自成立以来的经营模式均为 Fabless 模式，未曾发生变化，并将长期持续。公司专注于智能芯片的设计和营销，而将晶圆制造、封装测试等其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业及其他加工厂商代工完成。

公司主要通过向客户提供智能芯片及板卡、智能整机等产品获取收入。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段及基本特点:

根据中国证监会行业分类相关规定，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

随着人工智能技术的飞速发展，尤其是在大模型和通用人工智能领域，对底层芯片计算能力的需求正在以前所未有的速度增长。人工智能运算常常具有大运算量、高并发度、访存频繁的特点，且不同子领域所涉及的运算模式具有高度多样性，对于芯片的微架构、指令集、制造工艺甚至配套系统软件都提出了巨大的挑战。

与 CPU、GPU 等芯片相比，通用型智能芯片能够更好地匹配和支持人工智能算法中的关键运算操作，在性能和功耗上存在显著优势。根据最新的市场研究，人工智能芯片的市场规模正处于快速增长之中。Gartner 的报告预测，2027 年，全球人工智能芯片的市场的规模预计将达到 1,194 亿美元。根据国际数据公司 (IDC) 发布的《全球人工智能支出指南》，预计到 2027 年中国人工智能总投资规模将突破 400 亿美元，复合增长率为 25.6%，其中人工智能硬件在预测期内仍将为市场投资最主要的方向，占比超中国市场总规模的 60%。在政策强力支持、商业化加速落地、人工智能领域资金投入持续高速增长且硬件为主要投资方向的大背景下，智能芯片等智能基础设施具有广阔的市场前景和发展空间。

(2) 主要技术门槛：

集成电路设计行业属于技术密集型行业，而智能芯片作为集成电路领域新兴的方向，在集成电路和人工智能方面有着双重技术门槛。

公司所研发的通用型智能芯片产品，具备灵活的指令集和精巧的处理器架构，技术壁垒高但应用面广，可覆盖人工智能领域高度多样化的应用场景（如视觉、语音、自然语言理解、传统机器学习、生成式人工智能等）。通用型智能芯片及其基础系统软件的研发需要全面掌握核心芯片与系统软件的大量关键技术，技术难度高、涉及方向广，是一个极端复杂的系统工程。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 技术地位

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。公司掌握的智能处理器指令集、智能处理器微架构、智能芯片编程语言、智能芯片数学库等核心技术，具有壁垒高、研发难、应用广等特点，对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值。

公司凭借领先的核心技术，较早实现了多项技术的产品化。公司通过技术创新和设计优化，持续提升产品的性能、能效和易用性，推动产品竞争力不断提升。在报告期内，公司研发中的新一代智能处理器微架构及指令集将对自然语言处理大模型、视频图像生成大模型以及垂直类大模型的训练推理等场景进行重点优化，将在编程灵活性、易用性、性能、功耗、面积等方面提升产品竞争力。

同时，公司持续迭代训练软件平台与推理软件平台，均取得显著成效。其中，训练软件平台在适配模型的广度、模型训练性能、工具使用体验等方面均取得了进展。推理软件平台在技术创新、开源生态等方面持续推进研发与产品化工作，提升了系统级协同优化水平，稳固平台入口与用户基础。

(2) 市场地位

自2016年3月成立以来，公司快速实现了技术的产业化输出，先后推出了用于终端场景的寒武纪1A、寒武纪1H、寒武纪1M系列智能处理器；基于思元100、思元270、思元290芯片和思元370的云端智能加速卡系列产品；基于思元220芯片的边缘智能加速卡。其中，寒武纪智能处理器IP产品已集成于超过1亿台智能手机及其他智能终端设备中，思元系列产品也已应用于多家服务器厂商的产品中。此外，思元270芯片、思元290芯片还分别获得第六届世界互联网大会、世界人工智能大会颁布的奖项。思元220自发布以来，累计销量突破百万片。

报告期内，依托于公司在人工智能芯片产品、基础软件平台、集群软件工具链方面取得的长足进步，公司产品在运营商、金融、互联网等多个重点行业规模化部署，通过了客户严苛环境的验证，产品普适性、稳定性、易用性获得了客户的广泛认可。报告期内，公司产品紧密跟进开源生态，显著降低了客户的开发成本和迁移成本，为产品后续的推广奠定了坚实的产品和生态基础。

(3) 品牌优势

随着公司近年来的快速发展，成功推出了多款智能芯片及处理器IP产品。公司已建立起健全的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司凭借领先的产品性能、可靠的产品质量以及周到的技术支持，在市场中赢得了良好的口碑，不断巩固并提升公司在业界的知名度和影响力。

公司成立至今共获得多项荣誉：2017年12月，公司获得全球知名创投研究机构CB Insights颁布的“2018年全球人工智能企业100强”奖项；2018年11月，于深圳举办的第二届中国国际高新技术成果交易会上，寒武纪1M处理器、思元100智能芯片、思元100加速卡三款产品连续斩获高交会组委会颁发的“优秀创新产品奖”；同月，公司上榜由美国著名权威半导体杂志《EE Times》评选的“2018年全球60家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 60 of 2018）”

榜单；2019年6月，公司入选《福布斯》杂志中文版颁布的“2019福布斯中国最具创新力企业榜”；2019年10月，思元270芯片获得第六届乌镇世界互联网大会“世界互联网领先科技成果奖”；2020年4月，公司获得全球知名创投研究机构CB Insights颁布的“2020 IC DESIGN China”奖项；2020年6月，公司获得胡润研究院“2020胡润中国芯片设计10强民营企业”荣誉称号；2020年6月，公司上榜《EETimes》评选的“2020年全球100家最值得关注的半导体公司（EETimes Silicon 100）”榜单；2021年3月，公司上榜《EETimes》评选的“AI芯片公司（AI CHIP）TOP 10”榜单；2021年7月，公司的思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器获得了由世界人工智能大会组委会颁发的“SAIL之星”奖；2025年1月，公司获得胡润研究院“2024胡润中国人工智能企业50强”荣誉称号并位居榜首；2025年3月，公司获得全球电子工程领域权威技术媒体机构AspenCore颁布的“2025年度中国IC设计成就奖”奖项；2025年5月，公司入选福布斯中国颁布的“2025福布斯中国人工智能科技企业TOP 50”榜单；2025年11月，公司入选福布斯中国颁布的“2025福布斯中国创新力企业50强”榜单。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) AIGC 技术日益成熟，催生智能算力需求增长

AIGC（AI Generated Content，人工智能生成内容）指利用深度学习、自然语言处理、计算机视觉等技术，自动或半自动地生成文字、图像、音频、视频等多种形式的内容。随着模型训练方法的不断革新，以及各种行业对智能化需求的日益提升，AIGC技术在内容生产、虚拟人、智能客服等场景中得到了广泛应用，成为当前人工智能领域的重要发展方向。它能够大幅提升内容创作效率，降低人力成本，同时还为个性化与定制化服务带来更多可能性。由于相关算法和模型的不断优化，AIGC在内容质量与生成速度上的表现也在迅速进步，进一步推动了这一领域的蓬勃发展。

在AIGC技术迈向成熟的进程中，大规模预训练模型（简称“大模型”）在理解和生成内容方面的表现尤为突出。当前AIGC的技术底座是各类“大模型”，其中既包括专注于文本生成的大语言模型（Large Language Models，简称“大语言模型”），也包含适用于图像、视频等多模态生成任务的多模态模型。随着大模型的不断迭代，其所需的参数量呈指数级增长。以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大模型人工智能技术，从训练到推理都需要强大的算力支持。随着模型逐渐复杂化，对应的算力需求也水涨船高，智能芯片市场有望迎来新的增量需求。根据IDC测算，2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。预计到2027年，中国智能算力规模将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。

(2) 云计算、大数据、IoT 等新兴产业持续驱动智能芯片需求增长

当前，云计算架构已向智算中心全栈服务转型。IaaS层（“云”的基础设施）加速部署超大规模人工智能算力集群，PaaS层（“云”的操作系统）与SaaS层（“云”的应用服务）则通过深度整合大语言模型能力推动算力弹性调度与应用重构。与此同时，大数据产业从海量数据累积向高质量语料与实时知识库进化，对数据带宽及吞吐效率提出更高要求。在IoT、云计算和大数据等新兴技术日益成熟的背景下，无论数据储存在云端还是边缘，未来搭载智能芯片的计算载体数量仍将持续快速增长。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年	2023年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	13,437,714,065.91	6,717,812,509.70	100.03	6,418,036,122.33
归属于上市公司股东的净资产	11,836,173,972.81	5,422,658,659.68	118.27	5,649,838,776.60
营业收入	6,497,196,198.68	1,174,464,377.35	453.21	709,386,584.26
利润总额	2,059,381,570.35	-455,769,055.47	不适用	-874,738,791.05
归属于上市公司股东的净利润	2,059,228,538.67	-452,338,791.01	不适用	-848,440,140.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,769,934,157.68	-864,951,476.14	不适用	-1,042,862,484.00
经营活动产生的现金流量净额	-498,398,137.01	-1,617,960,236.90	不适用	-595,535,023.01
加权平均净资产收益率(%)	26.96	-8.18	增加35.14个百分点	-15.34
基本每股收益(元/股)	4.93	-1.09	不适用	-2.07
稀释每股收益(元/股)	4.88	-1.09	不适用	-2.07
研发投入占营业收入的比例(%)	17.99	91.30	减少73.31个百分点	157.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,111,398,926.80	1,769,244,544.29	1,726,780,892.57	1,889,771,835.02
归属于上市公司股东的净利润	355,465,241.04	682,617,327.53	566,563,175.54	454,582,794.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	275,962,803.95	636,604,043.12	506,321,130.23	351,046,180.38

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,399,358,712.85	2,310,509,034.58	-940,455,133.44	-469,093,325.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							52,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							66,525
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
陈天石	0	119,530,650	28.35	0	无		境内自然人
北京中科算源资产管理有限公司	0	65,669,721	15.57	0	无		国有法人
北京艾溪科技中心(有限合伙)	0	30,645,870	7.27	0	无		其他
香港中央结算有限公司	2,860,722	13,163,681	3.12	0	无		境外法人
章建平	1,476,117	6,814,868	1.62	0	无		境内自然人

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-8,316,236	5,351,199	1.27	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-3,744,903	4,987,866	1.18	17,626	无	其他
北京艾加溪科技中心（有限合伙）	-649,769	4,844,598	1.15	0	无	其他
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	-75,836	3,868,321	0.92	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-219,447	3,512,420	0.83	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	艾溪合伙的实际控制人为陈天石。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

存托凭证持有人情况

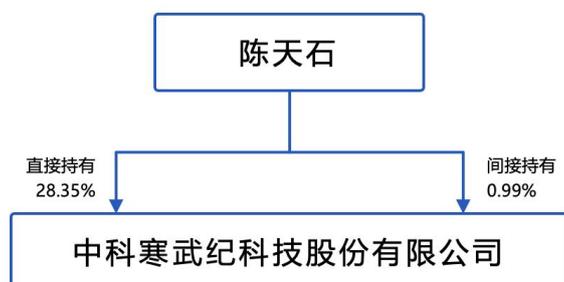
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

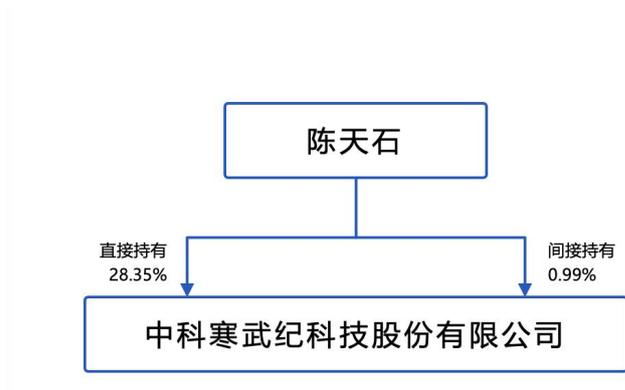
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入 649,719.62 万元，较上年同期增加 532,273.18 万元，同比增长 453.21%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为 205,922.85 万元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 176,993.42 万元，均实现了扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用